

	初級コース	基礎コース	成形・応用コース	油圧・電気コース	熱硬化性コース	スキルアップコース
	[3日間]	[5日間]	[5日間]	[5日間]	[5日間]	[1日]
2017年 3月						
4月	19日～21日					
5月	17日～19日					
6月		5日～9日				
7月			3日～7日			
8月		8月28日～9月1日				
9月		25日～29日				
10月		16日～20日				
11月				6日～10日	11月27日～12月1日	
12月		18日～22日				
2018年 1月		15日～19日	1月29日～2月2日			
2月				19日～23日		
3月						

- 開校時間／AM 8:30よりPM 4:45までです。
- 場 所／当社本社名機スクール内(愛知県大府市北崎町大根2番地)
- 募集人員／定員はスキルアップコースを除き各コースとも6名です。
定員をオーバーする場合は日程を変更していただくことがありますので、
ご了承ください。
- スキルアップコース 技能検定受験者用1日コースです。
●ご好評につき、3月も開校いたします。
●スキルアップコースは3月および5月から8月の間で予定しています。他のスクール開校日を除き、随時受付いたします。
●定員は1日1名です。

詳しくは各営業担当までお問い合わせください。▶▶ <http://www.meiki-ss.co.jp/sc/index.html>

2017 Calendar 2017年 年間カレンダー

1

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031

2

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728

3

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

262728293031

4

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23/30242526272829

5

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

123456

78910111213

14151617181920

21222324252627

28293031

6

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

123

45678910

11121314151617

18192021222324

252627282930

7

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

1

2345678

9101112131415

16171819202122

23/3024/312526272829

8

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031

9

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24252627282930

10

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

1234567

891011121314

15161718192021

22232425262728

293031

11

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

1234

567891011

12131415161718

19202122232425

2627282930

12

SUNMONTUEWEDTHUFRI

SAT

12

3456789

10111213141516

17181920212223

24/31252627282930

株式会社 名機製作所

営業拠点

東京支店 〒362-0011 埼玉県上尾市平塚840-1
中部支店 〒474-8666 愛知県大府市北崎町大根2番地
大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町2丁目1番43号 Choei62KYUHO江坂ビル・5F
静岡営業所 〒422-8036 静岡県静岡市駿河区敷地2-22-23
海外窓口 〒474-8666 愛知県大府市北崎町大根2番地

本社・工場 〒474-8666 愛知県大府市北崎町大根2番地
TEL (0562) 48-2111 (代) FAX (0562) 47-2316
URL <http://www.meiki-ss.co.jp>

TEL (048) 776-3811 (代) FAX (048) 776-3815
TEL (0562) 47-2391 (代) FAX (0562) 47-2395
TEL (06) 6386-2151 (代) FAX (06) 6386-0932
TEL (054) 238-0826 (代) FAX (054) 238-0827
TEL (0562) 48-2120 (代) FAX (0562) 47-2395

MEIKI NEWS

2017年1月発行 No. 193 名機ニュース

名機スクール
開校スケジュール
2017年度

繊維強化複合材への 取り組み

MVLP seriesのご紹介

第46回
インターネットコンジャパン
出展のご案内



新年明けまして
おめでとうございます。

旧年中は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
世界経済は、中国が減速感を強める中で英国のEU離脱、
米国の共和党政権への移行等、変化を求める動きがある一方
で、先行きの不透明感は益々増大している状況です。日本経
済においても個人消費が伸び悩んでおりますが、弊社の位置
する中部地区では自動車産業を中核として環境対応、自動
運転など次世代技術が急速に進み、今後とも国内産業界を
経済面、技術面から牽引していくものと思っております。
昨年、弊社は自動車用ランプの製造に使用される多色成形
機をご紹介することで、お客様の生産スタイルに適合する縦
型・横型、対向型の各種成形機をご提供できる「オンリーワン
企業」としてご評価頂きました。
この度は自動車関係の用途とは異なりますが、弊社の最も
得意とする「真空技術」を利用したラミネータをご紹介しま
す。弊社独自の技術が薄型ディスプレイ、ICチップの製造等に
使用されており、その適用分野は益々高機能化し拡がりつつあ
ります。「貼り合わせ」に関する技術的な課題やお困りの点が
ございましたら、是非ともお問い合わせ願えればと思ってお
ります。
本年も皆様にとつて良い一年になりますよう祈念申し上げ
ますとともに、今後も一層の御支援、御指導を賜りますよう心
よりお願い申し上げます。

代表取締役社長
村上 博司

繊維強化複合材への取り組み

ガラス繊維や炭素繊維を用いたFRP（繊維強化プラスチック）需要が増大しています。
金属に置き換わる軽量化素材として注目を浴び、採用する企業が分野問わず増え続けており
さらに日本産業を牽引する自動車分野においての燃費規制強化対応として、
車両構成部品の軽量化は急務であり、規制強化のマイルストーンとされている
2020年前後には急激な市場成長が予想されています。
ここでは繊維強化複合材への当社での取り組みをご紹介します。



複合材成形テスト機SEPICSを2014年に設置して以降、当装置の特徴でもある「射出プレス成形」「スタンピング成形」「圧縮成形」等複数の成形を実現できることから様々なテストや製品検討に対応しております。また、製造工程にあわせた仕様装置として、各企業様や研究施設に納入した実績も増えてきました。
今後は様々な製品、工法に対して幅広く対応するために、装置の大型化や製造工法に適応したスライド機構の開発を進めていきます。

プリント配線基板製造用の真空成形プレス機は、繊維強化シート成形（SMC）用の装置としても採用頂いております。
真空機能を有した本装置は、ボイド不良に対して有効です。
加熱方式はヒーター・油・蒸気および温調水より選択して頂けます。



これら以外にも材料メーカー様や大学、グループ企業株式会社日本製鋼所との技術連携を強化し、繊維強化複合材製造装置の開発を進めています。
本テーマにおける成形品や装置検討の際はご相談ください。お待ちしております。

当社は小型から超大型の射出成形機を製造し、自動車部品の射出成形用として数多くの実績を活かし、愛知県重点研究プロジェクトに本年度より参画しております。
研究テーマは「自動車軽量化のための熱可塑性炭素繊維強化樹脂の加工技術開発」で、当社はチョップドカーボンファイバーをオンラインブレンドする小型射出成形機の開発を担当します。岐阜大学守冨シニア教授を研究リーダーとし、産官学共同で2019年迄にCFRTPの自動車部品への適用を目指していきます。



MVLP seriesのご紹介

ラインナップ

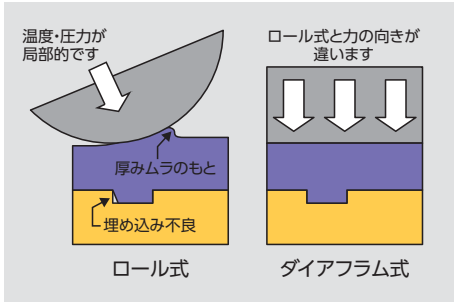
真空ダイアフラム式ラミネータMVLP (MEIKI VACUUM LAMINATOR PRESS) シリーズは2015年に開発した小型のMVLP300/300-S、平坦プレスステージを備えたMVLP500/600-IIWに加え、1995年に発売を開始し、2016年秋にリニューアル致しましたMVLPα500/600により構成されます。MVLPα500/600は今回で6世代目のマイナーチェンジとなり、トップランナー規制対応、真空性の向上、生産性の向上、省スペース化を実現しています。

用途

従来はプリント配線板の回路形成プロセス用のドライフィルムや多層板の絶縁材などのニッチな用途を主に販売してきました。最近特に増え始めたウェアラブル、タブレット、スマホ、これら製品は身に付け、持ち歩くものであり、持ち易さ（薄く、軽く）、扱い易さ（画面は見易く、動作は早く、アプリの多様化）、壊れにくさ（衝撃に強く、水に強く）が求められ続けています。これらの要求を満たすことは非常に困難で、各社アセンブルメーカーはアセンブルだけでなく独自に部品のマイクロ化を進め始めています。例えば内蔵基板の小型化や更なるファイン化、マイクロコンデンサ用の封止材フィルム（絶縁用材料）やドライフィルム（回路形成用フィルム）の貼り付けなどが挙げられます。

特長

MVLPシリーズはシリコンゴムで作られたダイアフラムという部品を空気で膨らませて、真空中で製品にフィルムを圧着させるラミネータです。他社製と比べダイアフラムのゴム質が柔らかく、製品面に面で圧着させるため凹凸に追従し易いという特長があります。一方、ロール式ラミネータは圧着させる部位が回転体であり、線状に圧着されていくため凹凸のあるものには対応しにくい傾向にあり



ます。MVLPシリーズの最大の特長は、ダイアフラム材の追従性、最高180℃の温度領域、最高1.0MPaの加圧力です。

今後の展開

今後は従来のノウハウ、特長を生かし、FOWLP (Fan Out Wafer Level Package) やNCF (フィルム型アンダーフィル) の封止への検討を含め、継続的にこれらのF/S (フィジビリティ・スタディ) を検討していきたいと考えています。

第46回 インターネプコンジャパン 出展のご案内 → <http://www.nepcon.jp/>

このたび当社は「第46回 インターネプコンジャパン」に出展参加いたします。
本会場では進化し続ける基板の薄肉化、高密度化はもちろん従来から実績を積んでおりますフレキシブル基板の感光性カバレイフィルムのラミネートや表面に凹凸のある形状物への追従埋め込みなど実装部品のラミネートに期待される真空ダイアフラム式ラミネータ「MVLPα500/600」を出展いたします。
ご多忙とは存じますが是非ご来場賜りますよう、ご案内申し上げます。

会 期：平成29年1月18日(水)～1月20日(金)
会 場：東京ビッグサイト/〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1
出 展 機：真空ダイアフラム式ラミネータ
弊社小間番号：東1号館 小間No.東1 E6-001

